



AUGUST 2007

BMBF schreibt Forschungsprämie aus

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas verlangt eine bessere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Besonders Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen müssen sich noch stärker als bisher Kooperationen mit der Wirtschaft öffnen. Mit der Forschungsprämie wird hierfür ein deutliches Signal gesetzt: Die Zusammenarbeit vor allem mit kleinen und mittleren Unternehmen lohnt sich.

Die Forschungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist eine der zentralen Aktivitäten der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Ideen sollen in Deutschland nicht mehr nur entwickelt, sondern hier auch in Produkte, Ver-

fahren und Dienstleistungen umgesetzt werden. Die Forschungsprämie ist daher als neues, technologieübergreifendes Instrument konzipiert. Ziel ist, in den Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen zusätzliche Potenziale für eine breite Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu mobilisieren. Dazu gibt die Forschungsprämie der öffentlichen Forschung den Anreiz, ihre Kompetenzen im Wissens- und Technologietransfer weiter auszubauen. So kann die Wissenschaft verstärkt einen Beitrag leisten, dass Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung (FuE) zügig zu Innovationen werden. Für das bis Ende 2009 befristete Förderinstrument werden insgesamt rund 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Quelle: Kompetenznetze.Deutschland

Wer kann die Forschungsprämie beantragen?

Öffentliche und staatlich anerkannte Hochschulen sowie die gemeinsam von Bund und Ländern finanzierten Forschungseinrichtungen können eine Forschungsprämie beantragen.

Wie hoch ist die Forschungsprämie?

Die Forschungsprämie beträgt 25 % des Auftragsvolumens (ohne Umsatzsteuer), mit einer Prämienuntergrenze von 2.500 Euro und einer Prämienobergrenze von 100.000 Euro pro FuE-Auftrag.

Anträge können laufend bis zum 30.09.2009 gestellt werden.

Weitere Informationen unter:
www.bmbf.de/foerderungen/7483.php und
www.fz-juelich.de/ptj/forschungspraemie/

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Die Forschungsprämie kann beantragt werden, wenn

- Ein FuE-Auftrag mit einem Volumen von mindestens 10 000€ ab dem Stichtag 01.09.2006 kontrahiert wurde.
- Der FuE-Auftrag für Unternehmen mit maximal 1.000 Beschäftigten durchgeführt und zu marktkonformen Bedingungen vergütet wurde.
- Die Laufzeit des FuE-Auftrages zwei Jahre nicht überstieg.
- Für den FuE-Auftrag sowohl auf Auftragnehmerseite als auch auf Auftraggeberseite keine öffentliche Förderung beantragt oder gewährt wurde.
- Der FuE-Auftrag durch Personal der Hochschule/Forschungseinrichtung durchgeführt wurde.

In dieser Ausgabe:

FORSCHUNGSPRÄMIE	1
VERANSTALTUNGSHINWEISE	1
PROGNOS TECHNOLOGIEREPORT	2
IFM2007	3
VON DER IDEE ZUM MARKTFÄHIGEN PRODUKT	3
SMART, MINIATURISIERT, VERNETZBAR	4
MECHATRONIK BEGREIFEN	5
INNOVATION FAIR 2007	5
ROBOTERPREIS AN IPA	6
PRÄSENTATION TECHNIKERARBEITEN	6
	7

Überblick Veranstaltungen

12. & 13. September 2007 – IFM2007, Winterthur

20. September 2007 – RFID in der Produktion – Wertschöpfung effizient gestalten, IWB TU München

24.—27. September 2007—Mechatronik begreifen, MOTEK, Neue Messe Stuttgart

17. Oktober 2007— In Rekordzeit von der Idee zum marktfähigen Produkt, TR-Systemtechnik, Trossingen

18. Oktober 2007—Mechatronik – Vorsprung durch Simulation, IWB TU München

19. bis 21. Oktober 2007—Eröffnung Neue Messe Stuttgart

29. Oktober 2007—forum kontakt 2007, Hochschule Esslingen, Standort Göppingen

29. November 2007—Innovation Fair, ICS, Neue Messe Stuttgart

TECHNOLOGIEREPORT DER PROGNOSE WIRFT BLICK AUF KÜNFTIGE TECHNOLOGISCHE TRENDS

Das Technologie-Expertenpanel der Prognos AG hat in 2006/2007 rund 70 Experten aus neun Ländern zu verschiedenen technologischen Entwicklungen befragt. Die technologischen Entwicklungen entstammen aus Themenfeldern wie Informations- und Kommunikationstechnik, Elektronik/Optik und Produktion/ Dienstleistung.

These: Produktionstechnologien mit eingebauter Elektronik zur autonomen Adaption an wechselnde Anforderungen werden bereits eingesetzt.

Eine innerhalb der Befragung behandelte These betrifft den Einsatz von Produktionstechnologien mit eingebauter Elektronik zur autonomen Adaption an wechselnde Anforderungen. Die Adaptive Elektronik - Adaption durch Elektronik - stellt dabei ein noch recht junges Forschungs- und Entwicklungsgebiet dar. Adaptive Strukturen beruhen auf Sensoren, Signalverarbeitung und Aktorik und sollen dazu dienen, Vibrationen zu dämpfen, Verfor-

mungen zu kontrollieren oder Bauteilschäden zu erkennen. Einsatzgebiete liegen vor allem im Fahrzeug- und Maschinenbau. Die These zum Einsatz entsprechender Produktionstechnologien fand hohe Zustimmung unter den Delphi-Experten. Technologische Herausforderungen bestehen jedoch noch im Einsatz von Verfahren, aktive Materialien wie z.B. Piezofasern mit metallischen Bauteilen zu verbinden. Deshalb sehen die Experten erst ab 2009 bzw. ab 2011 Chancen für verbesserte technische Lösungen und marktfähige Produkte.

These: Die Radio-Frequenz-Identifikation (RFID) bietet Unternehmensführungen die Ausnutzung neuer Produktivitätspotenziale

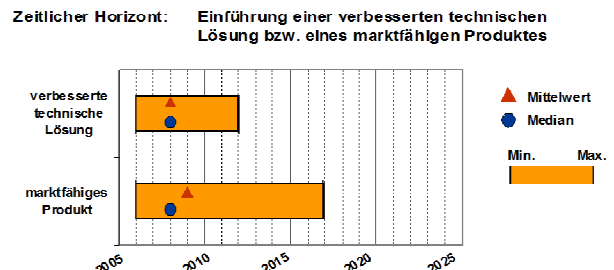
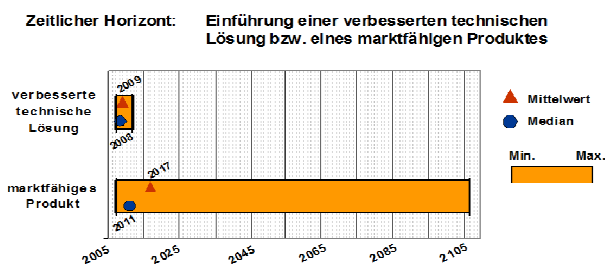
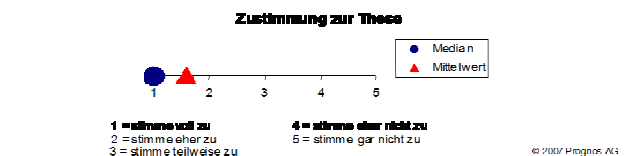
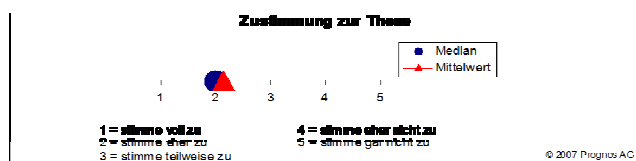
Eine weitere, in der Delphi-Befragung vertiefte These bezieht sich auf das Thema Radio Frequency Identification (RFID). Zukünftig erkennbar ist: RFID wird die Bereiche Produktion und Dienstleistung nachhaltig beeinflussen. Der zunehmende IT-Einsatz wird den Trend zur flexiblen Produktion und

individualisierten bzw. personalisierten Dienstleistung verstärken. Die bereits erfolgte Markteinführung einfacher RFID-Lösungen ist damit nur der Vorbote einer dynamischen Verbreitung intelligenterer RFID-Lösungen. Durch zunehmend intelligentere RFID-Lösungen wird ein immer breiteres Branchenspektrum erschlossen werden. Die Delphi-Experten gehen von verbesserten technischen Lösungen in 2008 bzw. marktfähige Lösungen bzw. Produkte in 2009 aus. Gearbeitet wird dabei an Fragen des Einsatzes intelligenter Transponder in rauen Umgebungen (Gehäusung) oder bei leitenden Oberflächen, entsprechende Hard- und Softwarearchitekturen, die die enormen Informationen auch bei mobilen Objekten verarbeiten und auslesefähig machen, Energieversorgungs- und Entsorgungsfragen sowie möglichst einheitliche technische Standards. Mithin ist eine verlängerte Zeitspanne für verbesserte technische Lösungen für marktfähige Produkte in einem Korridor von 2015 bis 2020 durchaus möglich.

Kontakt:
 Dr. habil. Oliver Pfirrmann
 Prognos AG
 Europäisches Zentrum für
 Wirtschaftsforschung und
 Strategieberatung
 Goethestraße 85
 D-10623 Berlin
 Tel.: +49 30 52 00 59-246
 Fax: +49 30 52 00 59-201
 oliver.pfirrmann@prognos.com

Der Bericht wurde im Frühjahr dieses Jahres von der Prognos AG veröffentlicht. Er kann gegen eine Schutzgebühr von 100 Euro bei Prognos direkt bestellt werden. Weitere Informationen zum Technologie-Expertenpanel und zum Bericht finden sich auch unter www.prognos.com/technologiepanel.

Diese Auswertung wurde speziell für das Kompetenznetzwerk Mechatronik erstellt.





Winterthur 12-13/09/07

Am 12. & 13. September 2007 findet in Winterthur das Internationale Forum Mechatronik (IFM) statt. Schwerpunkte der Konferenz sind die Vermittlung und der Austausch von aktuellem Fachwissen und anwendbaren Lösungen rund um die Entwicklung und den Einsatz von mechatronischen und insbesondere mikromechatronischen Systemen. Vorgelegt werden auch aktuelle Forschungsergebnisse, Best-Practice-Beispiele, Entwicklungstrends und innovative Arbeitsansätze.

Veranstalter sind verschiedene Netzwerke aus dem Herzen Europas. Das Kompetenznetzwerk Mechatronik ist dabei der baden-württembergische Vertreter. Die

Veranstaltungsreihe IFM soll den überregionalen Technologie- und Wissenstransfer zwischen den beteiligten Regionen fördern.

Verteilt über zwei Tage werden 42 Vorträge rund um die Mechatronik präsentiert. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung und verschiedenen Firmenbesichtigungen.

Aus dem Kompetenznetzwerk Mechatronik sind X Firmen und Forschungseinrichtungen mit Vorträgen dabei:

- efm-Systems GmbH
- Fraunhofer IPA
- Fraunhofer TEG
- Hochschule Esslingen
- HSG-IMIT



Seien Sie dabei und melden Sie sich an unter:
www.ifm2007.net
 Dort finden Sie auch weitere Informationen.

Im Jahr 2008 wird das IFM in Stuttgart auf der Neuen Messe parallel zur MOTEK stattfinden. Das Kompetenznetzwerk Mechatronik wird dabei Hauptveranstalter sein. Die Planungen laufen schon.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ifm2007.net

"IN REKORDZEIT VON DER IDEE ZUM MARKTFÄHIGEN PRODUKT"

Die Dialogreihe "High Speed in der produzierenden Industrie - Verfahren, Prozesse, Services" geht in die zweite Runde. Wie kann eine zündende Idee schnellstmöglich in ein marktfähiges Produkt umgesetzt werden?

Die zunehmende Entwicklung mechatronischer Systeme mit kürzer werdenden Produktlebenszyklen erfordert immer häufiger schnellere Produktionsanläufe und eine durchgängige Prozesskette vom Produktdesign bis zur Angebotserstellung. Den schnellen Produktionsanläufen müssen ebenso effiziente Entwicklungsprozesse vorgeschaltet sein. Ziel ist es, mittels neuer Methoden die komplexen Anforderungen an sichere und schnelle

Produktionsanläufe zu beherrschen und eine kürzest mögliche time-to-market für neue Produkte zu erreichen.

Wie High Speed in der Produktion aussehen kann, erfahren Sie am 17. Oktober bei der Firma TR-Systemtechnik in Trossingen.

Lernen Sie anhand von Praxisbeispielen, wie Sie vorhandene Informationen aus der Produktentwicklung vertriebsrelevant aufbereiten und damit neben einem schnellen Start in die Fertigung auch den Absatz Ihrer Produkte fokussieren.

Im Anschluss an die Vorträge können Sie Ihre Eindrücke bei einer Führung

durch die Produktion weiter vertiefen.

Beim Get Together, zu dem die Firma TR-Systemtechnik einlädt, können Sie sich austauschen und diskutieren.

Agenda

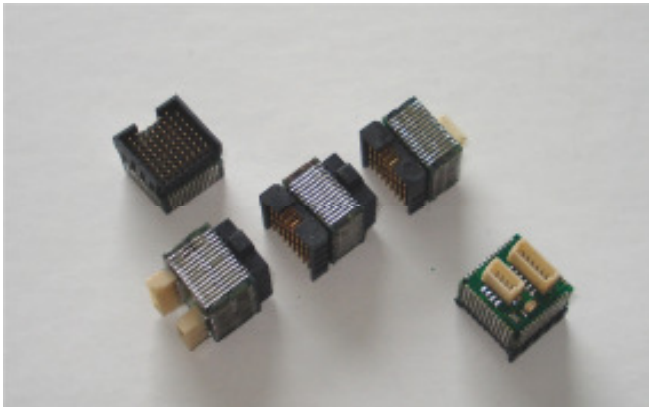
- 16:00 Uhr: Begrüßung
- 16:10 Uhr: Vortrag Dr. Paul Stauß, TR-Systemtechnik
- 16:35 Uhr: Vortrag Stefan Mattes, TR-Systemtechnik
- 17:00 Uhr: Vortrag Yvonne Wilmes, enovis-innovative Vertriebslösungen, Geschäftsführung "Vom Produktdesign zur Angebotserstellung in einer durchgängigen Prozesskette"
- 17:50 Uhr: Führung
- 18:45 Uhr: Get Together

Gemeinschaftliche Veranstaltung des Kompetenznetzwerk Mechatronik, von bwcon und von Photonics BW e.V.

*17. Oktober 2007
 16.00 – 18.45 Uhr,
 mit anschließendem Get Together und Führung
 In Trossingen bei der Firma TR-Systemtechnik*

SMART, MINIATURISIERT UND VERNETZBAR ...

... unter diesem Motto entwickelt und vertreibt die Firma efm-systems GmbH miniaturisierte Auswertesysteme für den Aufbau von smarten Sensor-/ Aktorsystemen. Alle Produkte verfügen über eine integrierte Signalverarbeitung, sind



busfähig und ermöglichen so die Realisierung komplexer Netzwerke und autonomer Regelkreise.

Das Produktportfolio umfasst neben kompletten Auswertesystemen auch einzelne Funktionsgruppen, die sich in Form von Bausteinen und Trägerplatinen über standardisierte Schnittstellen zu unterschiedlichen Systemen kombinieren lassen. Somit lassen sich die smarten Sensor-/ Aktorsysteme aus einem Baukasten anwendungsspezifisch zusammensetzen. Für den Aufbau der Systeme liegt seit einigen Monaten nun auch eine steckbare Variante vor, so dass die Aufbau und Verbindungstechnik nun „kinderleicht“ ist.

Anwendung finden die Systeme bereits heute in den unterschiedlichsten Branchen. Im Bereich Sensortechnik hat die Firma Temperaturmess-technik Geraberg GmbH auf Basis unserer Auswerteelektroniken eine komplette Produktreihe aufgelegt (MST-

Fühler). Auch die Firma T.V.P.-Gerds-GbR komplettiert Temperatur- und Drucksensoren mit den miniaturisierten Auswerteelektroniken zur Anbindung an Feldbuschnittstellen. Im Maschinenbau finden die Systeme Anwendung zur Überwachung und Regelung von Komponenten (z.B. Pumpenfabrik Ernst Scherzinger GmbH & Co. KG, Höfer & Bechtel GmbH). Im Bereich der Lehre und Ausbildung findet ein Einsatz z.B. an der TU Ilmenau gleich in mehreren Fachbereichen (Mechatronik, Informatik und Automatisierung sowie Mikroperipherik) statt. Auch zahlreiche andere Einrichtungen nutzen bereits das System.

Die Vorteile beim Einsatz dieser Systeme sind überzeugend:

Durch einheitliche Kommunikationsschnittstellen (CAN-Bus, Modbus) lassen sich Netzwerke mit unterschiedlichen Sensoren und Aktoren innerhalb kürzester Zeit aufbauen – Entwicklungszeiten und –kosten werden so deutlich reduziert.

Die Systeme bieten neben der reinen Messwerterfassung zusätzliche Möglichkeiten der Datenverarbeitung, der Überwachung oder der Regelung.

Verkablungs- und Installationsaufwand wie auch der Aufwand für die spätere Wartung (z.B. Kalibration) sinken deutlich.

Die Entwicklung eigener Systeme ist durch den Rückgriff auf getestete Funktionseinheiten einfach möglich, Expertenwissen und Expertenwerkzeuge können dadurch vielfach vermieden werden.

Bereits zu Entwicklungsbeginn ist ein Hardware/ Software Co-design auf Basis real vorhandener Funktionsgruppen in Hardware und zukünftig auch in Software möglich.

Weitere Informationen zur Firma efm-systems GmbH, gibt es unter der Telefonnr.: 0711/ 656771-11, per E-Mail: info@efm-systems.de oder im Internet unter www.efm-systems.de.



SONDERAUSSTELLUNG „MECHATRONIK BEGREIFEN“



Durch die Sonderschau „Mechatronik begreifen“ sollen die Messebesucher für das Thema „Mechatronik“ sensibilisiert werden. Das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Ingenieursdisziplinen generiert maximalen Nutzen für die eigenen Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Kompetenzträger präsentieren auf der „Mechatronischen Leistungsschau“ anschauliche Exponate und weisen anhand dieser Exponate auf die Schnittstellenproblematik der einzelnen Disziplinen der Mechatronik – insbesondere Mechanik und Elektrik – hin.

Im Fokus steht dabei das Vor-

gehen im Unternehmen als auch die konstruktive Ausrichtung im Projektieren der Anlage. Netzwerk und Potenziale der Mechatronik in der Handhabungstechnik – so heißen die zwei Ziele der Sonderschau. Wichtig ist der Aspekt des Konstrukteurs, sich mit der Verzahnung der Technologien und der Interdisziplinarität zu befassen und diese zu verstehen und zu realisieren. Know-how sowie realisierte Projekte mit Maschinenbauern stehen zur Diskussion auf der Standfläche, die passend zur Messe mit einer Ausstellung von Roboterhänden und ihrer mechatronischen Adaption von Greifern garniert ist.

In Expertenrunden werden Themen rund um die Frage „Wie wird Mechatronik in der Handhabungstechnik gelebt?“ diskutiert. Pro Tag sind 4 Expertenrunden geplant, jeweils in 30 Minuten-Diskussionen für die Besucher und Aussteller. Einladungen erfolgen direkt von den organisierenden Firmen.

Besuchen Sie die Sonderschau „Mechatronik begreifen“ auf der Motek 2007. weitere Informationen über die Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk Mechatronik.



INNOVAITION FAIR 2007

Das Kompetenznetzwerk Mechatronik ist in diesem Jahr Kooperationspartner der bwcon: Innovation Fair 2007. Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit zu ermäßigten Konditionen einen Ausstellerplatz auf der halbtägigen Innovationsmesse zu buchen. Kosten:

- Mitglieder € 250,-
- Nichtmitglieder € 350,-

Präsentieren Sie Ihre innovativsten Produkte, Prozesse und Services und gewinnen Sie den bwcon: Best Innovation Award 2007 der mit 3.000 € dotiert ist.

Die Innovation Fair 2006 fand im letzten Jahr erstmalig im Technologie Center der Festo AG in Esslingen statt und wird diesen Herbst im neuen Kongresszentrum der Stuttgarter Messe durchgeführt.

KMUs sowie Abteilungen und Projektteams aus For-

schungsinstituten und wissenschaftlichen Einrichtungen, haben dort die Möglichkeit, ihre neueste Innovation in den Bereichen Produkte, Prozesse und Services einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren. Gefragt sind Innovationen, die für die praxisnahe Anwendung entwickelt wurden und deren Innovationscharakter in unterschiedlichster Art zum Einsatz kommen kann. Die besten Innovationen werden von den Teilnehmern bewertet und mit dem bwcon: Best Innovation Award 2007 prämiert. Dabei werden 3 Preise in Höhe von jeweils 3.000,- EUR in den Bereichen Produkte, Prozesse und Services vergeben. Der Geldpreis wird gesponsert von der Agilent Technologies AG.

Die bwcon: Innovation Fair findet in diesem Jahr in Kooperation mit den Kompetenznetzwerk Mechatronik, Mikrosystemtechnik Baden-Württemberg und Photonics

BW - Kompetenznetz Optische Technologien im Internationalen Congresscenter Stuttgart auf dem neueröffneten Messegelände statt. Durch die Kooperation wird das Konzept der branchenübergreifenden und praxisnahen Innovationsförderung unterstrichen. Ziel ist es, die Innovationsakteure aus Baden-Württemberg zu vernetzen und somit das branchenübergreifende Innovationspotential zu fördern.

Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Geschäftsstelle.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch zahlreiche Mitglieder aus unserem Netzwerk auf der Innovation Fair begrüßen dürfen.

*29. November 2007,
14:00 - 18:00 Uhr*

*ICS Internationales Congresscenter Stuttgart
(auf der neuen Messe!)*



Fraunhofer
Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung

INTERNATIONALER ROBOTERPREIS ZUM 3. MAL ANS FRAUNHOFER IPA

Mit Martin Hägele erhielt am 13. Juli 2007 nach Prof. Warnecke und Prof. Schraft das Fraunhofer IPA anlässlich der "International Robots & Vision Show" in Rosemont (Chicago), Illinois, zum dritten Mal den international renommierten Roboterpreis "Joseph Engelberger Award". Durch die Preisvergabe wurde die herausragende Forschungsleistung von Martin Hägele gewürdigt, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in der Roboterszene Beachtung findet.

Er hatte Anteil an der Entwicklung und Nutzung neuartiger Roboter für Anwendungen außerhalb der Produktion, die heute als Serviceroboter bezeichnet werden. Als Leiter der Abteilung Robotersysteme am Fraunhofer IPA koordiniert er das EU-

Projekt "SMErobot", in dem die Entwicklung einer schnell zu installierenden und leicht zu bedienenden modularen und interaktiven Roboter- generation gemeinsam mit allen europäischen Roboterherstellern vorangetrieben wird. Ziel dieses Projekts ist vor allem die Entwicklung Robotern für kleine und mittelständische Produktionen.

Der Preis, benannt nach dem Begründer der Industrierobotik und "Vater" der modernen Robotikindustrie Joseph Engelberger. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Robotik und wird jährlich durch den amerikanischen Robotik-Verband, der Robotic Industries Association (RIA), an Personen verliehen, die sich um Fortschritte in der Robotik besonders

verdient gemacht haben. Seit seiner erstmaligen Verleihung im Jahre 1977 ging der Preis nun sechs Mal nach Deutschland.

Seit den 70er Jahren betreibt das Fraunhofer IPA Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Robotik, wobei die praktische Anwendung von Industrierobotern von Anfang an im Vordergrund stand. Durch unzählige Industrie- und Forschungsprojekte trug das Fraunhofer IPA wesentlich zum Siegeszug der Robotik in Deutschland bei. Das Institut ist heute ein gefragter Entwicklungspartner für Automatisierungslösungen in allen Industriebranchen und Technologiepartner für die Roboterhersteller.

Quelle: Kompetenznetze.Deutschland



Weitere Informationen:
[www.ipa.fraunhofer.de/
Arbeitsgebiete/
robotersysteme](http://www.ipa.fraunhofer.de/Arbeitsgebiete/robotersysteme)



FACHSCHULE FÜR TECHNIK—PRÄSENTATION VON TECHNIKERARBEITEN

Jedes Jahr im Juli werden an der Fachschule für Technik die Technikerarbeiten des vergangenen abgelaufenen Schuljahres präsentiert. Beim Abschluss zum staatl. geprüften Techniker gehört die Präsentation der Abschlussarbeit zum Qualifikationsnachweis. In Einzel- oder Gruppenarbeiten werden anspruchsvolle Aufgabenstellungen von den angehenden Technikern selbstständig bearbeitet, dokumentiert und präsentiert.

Viele Industrieunternehmen, darunter auch Partnerunternehmen des Netzwerks, ergreifen gerne die Chance, ihre aktuellen Themenstel-

lungen aus der Praxis den angehenden Technikern zur Verfügung zu stellen.

In diesem Jahr haben 40 angehende Techniker 25 Technikerarbeiten erstellt, die von den Lehrkräften der gewerblichen Schule Göppingen bzw. von den Firmen betreut und zum erfolgreichen Projektabschluss gebracht werden.

Themenstellungen wie

- Schwenkeinrichtung
- Externe Visualisierung von Maschinenzuständen
- Getaktete Motorsteuerung
- Handlingeinheit
- Sortiermaschine

- Fertigungsbegleitende Qualitätssicherung
 - Funkstandard Zig Bee
 - Diagnose-Software für einen CAN-Bus
 - USB-Sniffer
- zeigen den komplexen und innovativen Ansatz der Technikerarbeiten. Gerade in der aktuellen Situation des massiven Fachkräftemangels ist die Industriebeteiligung bei den Projektarbeiten eine „intelligente Lösung“ um kompetente Techniker als Mitarbeiter zu gewinnen.

Weitere Informationen bekommen Sie über die Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk Mechatronik

KOMPETENZNETZWERK MECHATRONIK GÖPPINGEN E.V.

Manfred-Wörner-Str. 115
73033 Göppingen

Telefon: 07161 - 965 950 - 0
Fax: 07161 - 965 950 - 5
E-Mail: info@mechatronik-ev.de
Www.mechatronik-ev.de



Das Kompetenznetzwerk Mechatronik ist ein Zusammenschluss von derzeit 74 Mitgliedsunternehmen. Zu den Schwerpunkt des Kompetenznetzwerk Mechatronik zählen aktuell folgende Bereiche:

- Produkt- & Prozesssimulation
- Neue Bus- und Feldbussysteme
- Medizin- und Biotechnik
- Labor- und Messtechnik
- Technisches Design
- Innovationsmanagement
- Werkzeugmaschinen
- Automatisierungstechnik
- Allgemeiner Maschinenbau
- Aus- und Weiterbildungsprogramme, Qualifizierung
- Automatisierte Fertigungsanlagen
- Optische Systeme
- Forschungsprojekte
- Ergebnistransfer von Verbundforschungsprojekten

Die Unterstützung von Partnerunternehmen bei der Verbreitung von Innovationen ist dabei ein spezielles Anliegen unseres Netzwerks. Täglich werden in Deutschland neue Innovationen entwickelt und vorgestellt. Wir sehen eine unserer Aufgaben darin, Innovationen von einer Branche in eine andere zu tragen und diese damit branchenübergreifend nutzbar zu machen.

FORUM KONTAKT 2007 KONTAKTMESSE AN DER HOCHSCHULE IN GÖPPINGEN

Am 29. Oktober 2007 veranstaltet die Wirtschaftsförderung des Landkreis Göppingen an der Hochschule in Göppingen eine Kontaktmesse.

Ziel dieser Messe ist es, den Kontakt zwischen Unternehmen der Region und zu Studenten, Praktikanten, Diplomanten und Absolventen der lokal ansässigen Hochschulen (Göppingen, Esslingen, Stuttgart, Ulm, Aalen, Nürtingen, Geislingen, etc.) zu fördern.

Schwerpunktmäßig ist die Messe für Unternehmen aus dem Kreis Göppingen vorgesehen. Für die Mitglieder des Kompetenznetzwerk Mechatronik, die nicht im Kreis Göppingen ansässig sind, besteht aber ebenfalls die Chance, sich auf dieser messe zu präsentieren.

Mit der Anmeldung zur Messe wird auch ein hochwertiger Katalog erstellt, in dem Firmen mit einem Kurzprofil, einem Ansprechpartner, konkretem Personalbedarf und Terminen für Firmenbe-

sichtigungen (nur wenn gewünscht) vorgestellt werden.

Nutzen Sie diese Chance. Präsentieren Sie sich mit einem eigenen Messestand und suchen Sie nach potentiellen Nachwuchskräften für technische und betriebswirtschaftliche Aufgaben.

Die Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk Mechatronik steht Ihnen gern für weitere Fragen zur Verfügung.

*29. Oktober 2007
12:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Hochschule Esslingen,
Standort Göppingen*